

SMコンタクト

SM contact

SM-D series



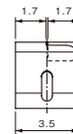
- 材 質 /Material リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze (t = 0.1 mm)
- メッキ処理 /Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range SM-D733735-PB
高さ = 1.7 ~ 3.5mm Height: 1.7 mm to 3.5 mm
SM-D906039-PB
高さ = 3.5 ~ 5.8mm Height: 3.5 mm to 5.8 mm

用途

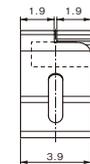
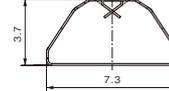
Applications

- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、
家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

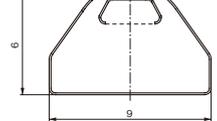
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.



SM-D733735-PB



[単位 Unit:mm]

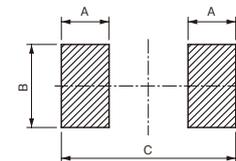


SM-D906039-PB

品番表

Product list

| 品番 Product code | 寸法[mm] Dimensions [mm] | | | 標準梱包数量 Standard packaging quantity | |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---------------------------------------|--|
| | A | B | C | テーピング Taping | ダンボール Corrugated cardboard |
| SM-D733735-PB | 2 | 3.5 | 7.3 | 2,500ヶ (リール) 2,500/reel | 30,000ヶ (外箱) 12リール/1箱梱包 30,000/box (12 reels are packed in each box.) |
| SM-D906039-PB | 2 | 3.9 | 9.0 | 1,800ヶ (リール) 1,800/reel | 21,600ヶ (外箱) 12リール/1箱梱包 21,600/box (12 reels are packed in each box.) |

ランド寸法図
Land dimensions

特性

Physical properties

| 試験項目 Test item | 性能・規格 Performance/specifications | 試験方法及び条件 |
|---|--|---|
| 初期抵抗値 Initial resistance | 0.01Ω以下 0.01Ω or less | 測定用基板上に半田付けし、製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した時の抵抗値を測定する。 |
| 圧縮荷重 Compressive load | 5N以下 (SM-D733735-PB) 5 N or less (SM-D733735-PB) 2.2N以下 (SM-D906039-PB) 2.2 N or less (SM-D906039-PB) | 測定用基板上に半田付けし、製品を2.5mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。 測定用基板上に半田付けし、製品を4.2mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。 |
| 高温試験 High temperature test | 0.01Ω以下 0.01Ω or less | 製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: 85°C 処理時間: 500hr |
| 耐湿試験 Humidity test | 0.01Ω以下 0.01Ω or less | 製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: 60°C/95%RH 処理時間: 500hr |
| 低温試験 Low temperature test | 0.01Ω以下 0.01Ω or less | 製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: -40°C 処理時間: 500hr |
| ヒートサイクル試験 Temperature cycle test | 0.01Ω以下 0.01Ω or less | 製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: -40°C (1hr) ~85°C (1hr) 処理時間: 100サイクル |
| 圧縮永久歪率測定 Compression set measurement | 30%以下 30% or less | 製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後の歪率の測定を行なう。処理温度: -40°C (3hr) ~85°C (3hr) 処理時間: 12サイクル 歪率 (%) = (t0-t1)/(t0-t2) x100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペーサー |
| 半田濡れ性試験 Solder wettability test | 浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder. | 半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比率25%とする。半田温度: 245±3°C 浸漬時間: 3sec. (SM-D733735-PB)、5sec. (SM-D906039-PB) |